

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-058

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于全资子公司向银行融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度公司对外借款及相关授权事宜的议案》，同意公司（含子公司）向各类金融机构、融资租赁机构及其他第三方（不含关联方）申请累计不超过人民币10亿元的综合授信额度，公司为子公司的融资提供合计人民币不超过8亿元的担保额度，前述担保额度包含：公司为子公司提供担保；子公司为本公司提供担保；子公司之间的相互担保。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经2025年度股东会审议通过。

近日，重庆三峡银行股份有限公司（以下简称“三峡银行”）同意给全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆惠伦”）人民币550万元续授信额度，期限11个月，由实际控制人赵积清先生与公司提供连带责任保证担保，具体交易事宜，以实际所签合同为准。

公司与三峡银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：重庆三峡银行股份有限公司

统一社会信用代码：915001017116939742

注册资本：557,397.496万人民币

成立日期：1988年2月16日

住所：重庆市万州区白岩路3号

经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、累计综合授信额度

如上述交易完成后，公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币 59,550.00 万元，涉及的累计担保为人民币 53,950.00 万元，本次融资事项在 2025 年度股东会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的一切事宜，无需再提交董事会或股东会审议。

四、交易目的及对公司的影响

重庆惠伦进行银行融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

三峡银行借款合同及相关文件。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日